



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20071116001
2007年11月27日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎

TI-Sherman LBC3S (SPWELL) プロセス MAX3243xx/TRS3243xx 製品追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input checked="" type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	TI-Sherman LBC3S:SPWELL プロセス MAX3243xx/TRS3243xx 製品追加 現行：TI-Dallas、TI-Houston 変更後：TI-Dallas、TI-Houston、 TI-Sherman (LBC3S:SPWELL)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2008年2月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) MAX3243xx/TRS3243xx製品について、現行TI-Dallasにて製造いたしておりますが、これに加えTI-Sherman LBC3S/SPWELLプロセス製品を追加し認定いたしました。追加に伴うデータシート及び製品名の更新はなく現行製品と同様にご使用いただけます。TI-Shermanサイト LBC3S/SPWELLプロセスは、弊社の他SLL製品にて既に適用し量産を継続しているものになります。

変更内容	現行	変更後
製造サイト	TI-Dallas TI-Houston	TI-Dallas TI-Houston TI-Sherman (LBC3S/SPWELL)

評価用サンプル/開始期日： TRS3243CDBR / 2007年11月20日
 TRS3243CDWR / 2007年11月20日
 TRS3243CPWR / 2007年11月20日

理由：製品安定供給確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
MAX3243CDB	MAX3243CDWRG4	MAX3243IDBE4	MAX3243IPWR	TRS3243CPWR
MAX3243CDBE4	MAX3243CPW	MAX3243IDBR	MAX3243IPWRG4	TRS3243IDB
MAX3243CDBR	MAX3243CPWG4	MAX3243IDBRE4	TRS3243CDB	TRS3243IDBR
MAX3243CDBRE4	MAX3243CPWR	MAX3243IDW	TRS3243CDBR	TRS3243IDW
MAX3243CDBRG4	MAX3243CPWRE4	MAX3243IDWR	TRS3243CDW	TRS3243IDWR
MAX3243CDW	MAX3243CPWRG4	MAX3243IPW	TRS3243CDWR	TRS3243IPW
MAX3243CDWR	MAX3243IDB	MAX3243IPWG4	TRS3243CPW	TRS3243IPWR

信頼性試験

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	2007年6月20日	終了
			2007年7月25日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qualification Device:	TRS3243CDB	Die Rev/ Size(mils)	H / 139 x 84
Wafer Fab Site:	SHE	Technology/Fab Process :	BiCMOS / LBC3S
Metal1-2:	TiW/AICu.5%	Passivation:	10KACN
Assembly Site:	MLA	Package / Pin:	DB / 28
Mount Compound:	HIT EN-4088Z	Mold Compound:	LOC GR825-73B
Bond:	TS-0.95 Au	L/F Composition / Finish:	Cu / NiPdAu
MSL:	LEVEL1-260CG	Flammability Rating:	UL 94 V0
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails
** Steady-State Life Test	150C,300 hrs		116/0
** Biased HAST	130C/85%RH,96 hrs		77/0
** Autoclave	121C,96 hrs		77/0
** Temperature Cycle	-65/150C,1000 cys		77/0
ESD - HBM	3000 V		3/0
ESD - HBM (HIGH)	15000 V		3/0
ESD - MM	100 V		3/0
ESD - CDM	1000 V		3/0
Latch-up	JESD78, Class II		6/0
X-Ray Inspection	Per Assembly Site spec		5/0
Characterization	Per Products Spec		passed
Manufacturability	Per Mfg Site Spec		Approved
** Preconditioning Sequence: JEDEC Level 1/260C			